

行业及产业

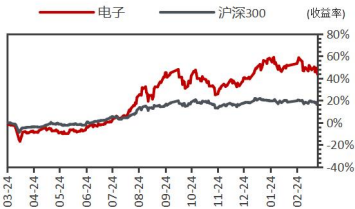
电子

Micron 2026 财年 Q2 单季度业绩创历史新高

——电子行业周报 (2026/3/16-3/22)

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势:



资料来源: 聚源数据, 爱建证券研究所

相关研究

- 《电子行业周报: AMAT 携手 SK hynix、Micron 合作开发新一代存储芯片》2026-03-16
- 《电子行业跟踪报告: NVIDIA 投资 40 亿美元扩产光芯片》2026-03-11
- 《电子行业跟踪报告: MLCC 或迎来涨价周期》2026-03-02
- 《电子行业跟踪报告: 字节跳动发布 Seedance 2.0》2026-02-24
- 《电子行业跟踪报告: 摩尔线程推出智能编程服务》2026-02-09

证券分析师

许亮
S0820525010002
0755-83562506
xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇
S0820125040021
021-32229888-25520
zhujunyu@ajzq.com

投资要点:

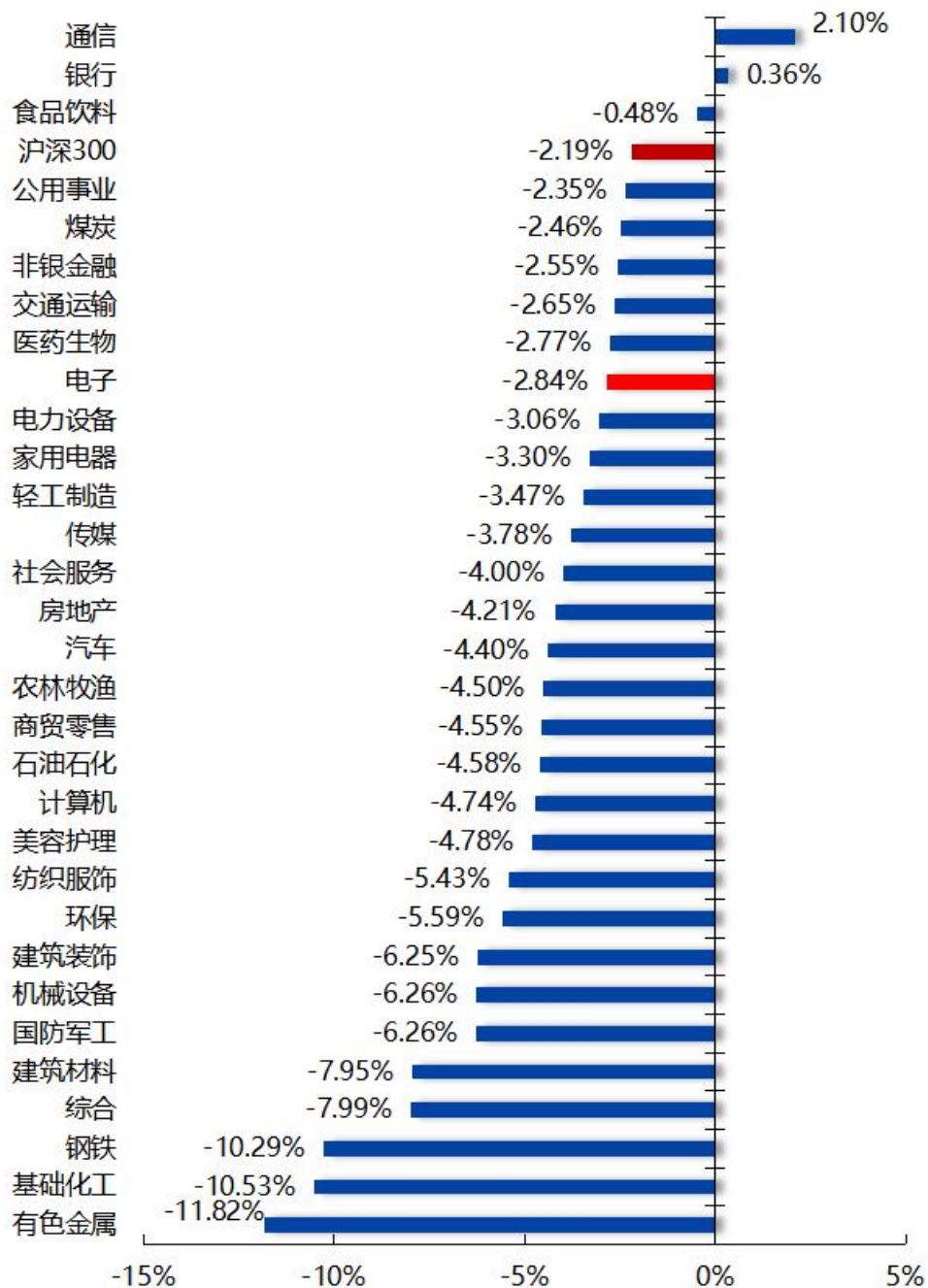
- 本周 (2026/3/16-3/22) SW 电子行业指数 (-2.84%)，涨跌幅排名 9/31 位，沪深 300 指数 (-2.19%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：通信 (+2.10%)，银行 (+0.36%)，食品饮料 (-0.48%)，公用事业 (-2.35%)，煤炭 (-2.46%)，涨跌幅后五分别为：有色金属 (-11.82%)，基础化工 (-10.53%)，钢铁 (-10.29%)，综合 (-7.99%)，建筑材料 (-7.95%)。本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：分立器件 (+5.17%)，半导体设备 (+0.16%)，印制电路板 (-0.74%)，涨跌幅后三分别是：LED (-7.04%)，电子化学品Ⅲ (-6.65%)，半导体材料 (-6.01%)。
- 本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：深华发 A (+61.01%)，源杰科技 (+26.80%)，国科微 (+21.34%)，长光华芯 (+17.39%)，雅创电子 (+15.31%)。涨跌幅排名后五的股票分别是：华灿光电 (-16.14%)，京泉华 (-15.35%)，铜峰电子 (-15.23%)，威尔高 (-14.58%)，中富电路 (-14.34%)。
- **Micron 发布 2026 财年第二季度财报。**美东时间 2026 年 3 月 18 日，Micron 发布 2026 财年第二季度财报。当期公司实现营业收入 238.6 亿美元，同比增长 196.3%、环比增长 74.9%；归母净利润 137.85 亿美元，同比增长 770.8%、环比增长 163.1%；综合毛利率达 74.41%，创公司历史新高。分业务来看，DRAM 业务实现营收 188 亿美元，同比增长 207%、环比增长 74%，营收占比 79%，受行业供需紧张及 AI 服务器高端需求拉动，产品 ASP 环比上涨约 65%；NAND Flash 业务营收 50 亿美元创历史新高，同比增长 169%、环比增长 82%，营收占比 21%，凭借高毛利企业级产品优化结构，产品 ASP 环比上涨 75%-79%。为匹配市场需求，公司上调资本开支规划，2026 财年资本支出预计超 250 亿美元，2027 财年将继续大幅增长，重点投向 HBM 及 DRAM 产能建设。
- **Samsung 深化与 NVIDIA 合作，公布 2nm HBM5 开发计划。**2026 年 3 月 17 日，据韩国媒体 Business Korea 报道，Samsung 正式披露下一代高带宽内存 (HBM) 技术开发路线，同时官宣与 NVIDIA 的产业链合作进一步深化。公司已确认正在开发第八代高带宽内存 HBM5，该产品核心底层芯片 (Base die) 将采用 Samsung 自研的 2nm 工艺打造；针对第九代迭代产品 HBM5E，Samsung 计划提前在核心存储芯片上应用基于 1D 工艺 (第七代 10 纳米级) 的 DRAM，提前锁定高端 AI 存储赛道的技术先优优势。此外，NVIDIA 在本届 GTC 2026 大会上重磅发布的新款人工智能 (AI) 推理专用芯片 “Groq 3 语言处理单元 (LPU)”，已正式委托三星晶圆代工事业部负责生产，将采用三星已实现成熟量产的 4nm 工艺制造，此次合作不仅标志着 Samsung 与 NVIDIA 的产业绑定从此前单一的存储芯片供应，延伸至先进制程晶圆代工的全链条合作。
- **NVIDIA 将与 Qnity Electronics 合作研发半导体先进材料。**2026 年 3 月 18 日，NVIDIA 宣布与 Qnity Electronics 达成合作，共同研发用于半导体制造的先进材料，以及面向人工智能与高性能计算的先进封装技术。Qnity Electronics 于 2025 年 11 月从杜邦公司电子业务部门分拆而来，技术布局覆盖芯片制造、先进封装、热管理三大板块；2025 年财报显示，公司 15% 的营收已锁定 AI 数据中心市场。
- **投资建议：**Micron 2026Q2 业绩爆发，AI 驱动高端存储量价齐升；Samsung 作为 NVIDIA Rubin 架构核心 HBM 供应商，产能已通过长单全额锁定，进一步印证存储行业高景气度。当前存储涨价周期持续上行，建议重点关注国产存储产业链上市公司投资机会。
- **风险提示：**AI 算力需求不及预期；存储芯片价格上涨不及预期；技术迭代不及预期的风险。

1. 本周市场回顾

1.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子行业指数 (-2.84%)，涨跌幅排名 9/31 位，沪深 300 指数 (-2.19%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：通信 (+2.10%)，银行 (+0.36%)，食品饮料 (-0.48%)，公用事业 (-2.35%)，煤炭 (-2.46%)，涨跌幅后五分别为：有色金属 (-11.82%)，基础化工 (-10.53%)，钢铁 (-10.29%)，综合 (-7.99%)，建筑材料 (-7.95%)。

图表 1：本周 SW 一级行业涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：分立器件（+5.17%），半导体设备（+0.16%），印制电路板（-0.74%），涨跌幅后三分别是：LED（-7.04%），电子化学品Ⅲ（-6.65%），半导体材料（-6.01%）。

图表 2：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览



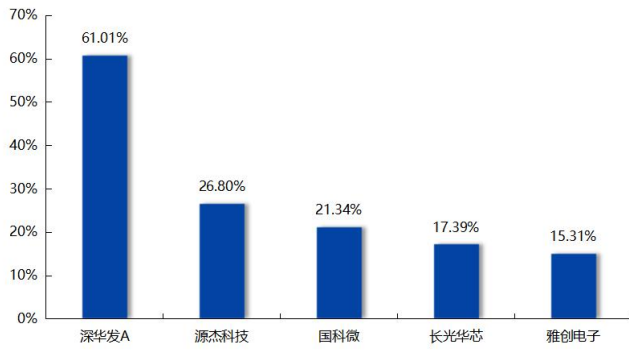
资料来源：iFinD，爱建证券研究所

1.3 SW 电子行业个股情况

本周 SW 电子行业涨跌幅排名前五的股票分别是：深华发 A（+61.01%），源杰科技（+26.80%），国科微（+21.34%），长光华芯（+17.39%），雅创电子（+15.31%）。

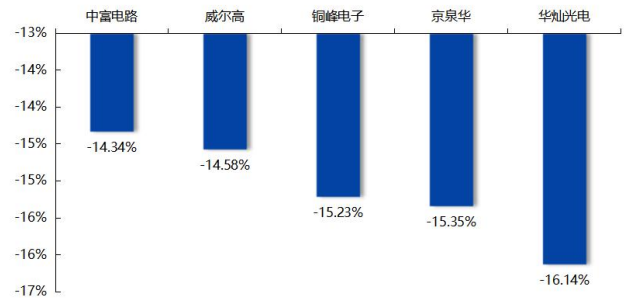
涨跌幅排名后五的股票分别是：华灿光电（-16.14%），京泉华（-15.35%），铜峰电子（-15.23%），威尔高（-14.58%），中富电路（-14.34%）。

图表 3: SW 电子个股本周涨跌幅前五



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

图表 4: SW 电子个股本周涨跌幅后五

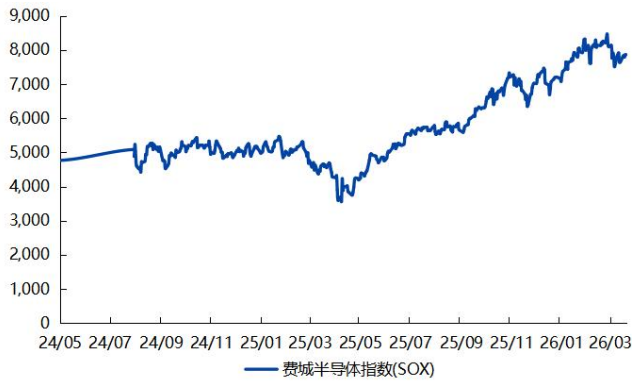


资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

1.4 SW 科技行业其他市场表现

半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为+0.31%，恒生科技指数本周涨跌幅为-2.12%。

图表 5: 本周费城半导体指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

图表 6: 本周恒生科技指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

中国台湾电子指数各板块本周涨跌幅分别是: 半导体 (-0.41%), 电子 (+0.60%), 电脑及周边设备 (+0.03%), 光电 (-0.71%), 通信网路 (+4.61%), 电子零组件 (+6.43%), 电子通路 (+8.64%), 资讯服务 (-0.94%), 其他电子 (-1.67%)。

图表 7: 2025 年 4 月-2026 年 3 月中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

2. 全球产业动态

2.1 Micron 发布 2026 财年第二季度财报

美东时间 2026 年 3 月 18 日, Micron 公布 2026 财年第二季度财报。财报数据显示, 公司当期营业收入达 238.6 亿美元, 同比增长 196.29%, 环比增长 74.89%; 净利润达 137.85 亿美元, 同比增长 770.81%, 环比增长 163.07%; 当期毛利率达 74.41%。

分业务板块来看, Micron 2026 财年第二季度业绩增长由 DRAM 与 NAND Flash 存储业务共同拉动:

1) DRAM 业务: 当期实现营收 188 亿美元, 同比大幅增长 207%, 环比增长 74%, 营收占比达 79%。受全球存储行业供需持续紧张、AI 服务器高端 DRAM 需求井喷推动, 本季度 DRAM 产品 ASP 环比上涨约 65%。

2) NAND Flash 业务: 当期营收创下 50 亿美元的历史新高, 同比增长 169%, 环比增长 82%, 营收占比为 21%。尽管消费级市场竞争仍较为激烈, 但公司凭借高毛利的企业级、数据中心级产品优化产品组合, 推动 NAND 产品 ASP 环比涨幅达 75%-79%。

为满足持续攀升的市场需求, 美光大幅加码全球制造布局。2026 财年资本支出预计将超过 250 亿美元, 此次增加的部分主要源于与洁净室设施相关的资本支出, 包括已完成收购的力晶半导体铜锣厂及美国晶圆厂项目。Micron 预计, 2027 财年资本支

出将继续大幅增长，以支持与 HBM 及 DRAM 相关的投资。其中建设相关支出同比增加超 100 亿美元。

全球扩产方面，铜锣厂预计 2028 财年开始出货，爱达荷州首座晶圆厂预计 2027 年中期投产，纽约晶圆厂已动工，日本广岛洁净室扩建顺利推进；NAND 领域，新加坡新工厂已破土动工，预计 2028 年下半年投产；印度组装测试工厂已实现商业发货，新加坡 HBM 封装工厂预计 2027 年投入运营。

2.2 Samsung 深化与 NVIDIA 合作，公布 2nm HBM 开发计划

2026 年 3 月 17 日，据韩国媒体 Business korea 报道，Samsung 已确认正在开发第八代高宽带内存 HBM5，其底层芯片（Base die）将采用 2nm 工艺。对于第九代 HBM5E，该公司计划提前在核心芯片上应用基于 1D（第七代 10 纳米级）工艺的 DRAM。

同时，NVIDIA 在本届 GTC 2026 大会上重磅发布的新款人工智能（AI）推理专用芯片“Groq 3 语言处理单元（LPU）”，已正式委托三星晶圆代工事业部负责生产，将采用三星成熟量产的 4nm 工艺制造。此次合作也标志着 Samsung 与 NVIDIA 的产业绑定，从此前单一的存储芯片供应，延伸至先进制程晶圆代工领域，同时也是 NVIDIA 推进 AI 芯片供应链多元化布局的关键动作。

2.3 NVIDIA 将与 Qnity Electronics 合作研发半导体先进材料

2026 年 3 月 18 日，NVIDIA 宣布与 Qnity Electronics 达成合作，共同研发用于半导体制造的先进材料，以及面向人工智能与高性能计算的先进封装技术。

Qnity Electronics 于 2025 年 11 月从杜邦公司电子业务部门分拆而来，技术布局覆盖芯片制造、先进封装、热管理三大板块；2025 年财报显示，公司 15% 的营收已锁定 AI 数据中心市场。

2.4 领益智造旗下立敏达成为 NVIDIA Rubin 架构供应商

2026 年 3 月 16 日 GTC 大会期间，领益智造旗下子公司立敏达（Readore）作为中国大陆企业，正式进入英伟达新一代 Rubin 架构 Manifold（分水器）生态，现场展出 UQD/MQD 快接头、Inner Manifold 等核心液冷产品。

NVIDIA 本次发布的 Rubin 全液冷架构，通过冷板吸收芯片运行热量，经由 Inner Manifold、UQD/MQD 快接头、Rack Manifold 组成的管路系统完成外部热交换，冷却液回流形成闭环散热。

随着 Rubin GPU 功耗突破 2000W，全液冷已成为 AI 算力标配，液冷市场加速放量。

2.5 STMicroelectronics 宣布与 NVIDIA 合作开发 Physical AI

2026年3月16日，STMicroelectronics（意法半导体）宣布与NVIDIA合作开发Physical AI，重点覆盖人形机器人、工业机器人、服务机器人及医疗保健机器人四大领域。

STMicroelectronics将发挥其在硬件领域的优势，把自身传感器、微控制器和电机控制解决方案，全面集成到英伟达机器人生态系统中，实现软硬件协同发力，助力物理人工智能技术在各类机器人场景的快速落地。

3. 风险提示

- 1) AI 算力需求不及预期。**当前半导体行业多数细分赛道的增长核心依赖全球AI算力建设的持续放量，若大模型技术落地进度不及预期，导致全球云厂商、AI企业的资本开支收缩，将直接影响AI芯片、存储等配套产业链的需求增长。
- 2) 存储芯片价格上涨不及预期。**当前存储板块的核心投资逻辑依赖产品ASP持续上涨带来的业绩弹性，若存储厂商扩产进度超预期、AI服务器高端需求放缓，将造成存储芯片价格上涨不及预期甚至回落。
- 3) 技术迭代不及预期的风险。**半导体行业技术迭代速度快，HBM、先进制程、先进封装、Physical AI等领域均存在持续的技术升级需求，若相关企业技术研发进度不及预期，将面临产品竞争力下滑的风险。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5%~5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归属爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。